

2026 臺美科技人才、創新研發暨產業投資合作高峰會

敬 邀 函

2026 Taiwan-U.S. Summit on Technology Talent, Innovative R&D and Industrial Investment Cooperation

敬愛的校長、副校長、教務長、院長、教授及技術移轉中心 (Technology Transfer Office, TTO) 主管 您好：

謹代表台灣學聯 (Taiwan Aeon Corporation)，誠摯邀請貴校參與「2026 臺美科技人才、創新研發暨產業投資合作高峰會」。本次高峰會不僅是一場國際盛事，更旨在為臺美雙方搭建一個前瞻性的合作平台，深度鏈結科技人才、創新研發與產業投資，共創互惠共榮的未來。

當前，全球科技浪潮洶湧，人工智慧 (AI)、半導體、機器人、智慧製造、航太科技、新材料及能源科技等領域正引領新一輪的產業變革。大學、政府及產業三方的緊密合作，已成為推動科技創新、技術商品化及產業升級的重要關鍵。美國憑藉其世界頂尖的學術機構、卓越的科研能量、成熟的技術移轉制度 (Technology Transfer) 及蓬勃發展的新創生態系，持續孕育出無數具商業化潛力的創新成果。而臺灣則以其全球領先的半導體產業、高科技製造實力及完整的供應鏈優勢，在全球經濟版圖中佔據舉足輕重的地位。雙方若能進一步深化合作，將可共同創造更多創新研發與產業發展的新契機。

本次高峰會旨在建立一個長期且具影響力的臺美科技合作平台，串聯：

美國州政府 × 美國大學 × 技術移轉中心 (TTO) × 研究中心 × 新創育成中心 × 臺灣企業 × 臺灣各大學 × 政府單位

共同推動：

- | | |
|--------------|-------------|
| ✓ 科技人才培育與交流 | ✓ 技術移轉與專利授權 |
| ✓ 聯合研發合作 | ✓ 創新創業與新創育成 |
| ✓ 產學合作與技術商品化 | ✓ 跨國合作與市場拓展 |

誠摯邀請貴校參與

我們誠摯邀請貴校校級主管、教授、研究人員及技術移轉中心 (TTO) 代表參與本次高峰會，共同分享研究成果，拓展國際合作機會。

參與本次高峰會，貴校將有機會：

- ▶ 展示最新科研成果與創新技術。
- ▶ 發表具商業化潛力的研究成果、專利及技術。
- ▶ 與臺灣高科技企業面對面交流合作需求。

- ▶ 與美方探索共同研發與跨國合作機會。
- ▶ 建立長期產學合作夥伴關係。
- ▶ 拓展技術商品化及全球市場合作契機。

創新技術展示 (Innovation Showcase)

本次高峰會將設置「**創新技術展示區**」，邀請各校展示最新研發成果，包括：

- | | |
|---------------|----------|
| ✓ 半導體技術 | ✓ 新材料 |
| ✓ 智慧製造 | ✓ 感測器技術 |
| ✓ 人工智慧 (AI) | ✓ 光電技術 |
| ✓ 機器人技術 | ✓ 能源科技 |
| ✓ 航太科技 | ✓ 其他前瞻科技 |

各校可展示最新研究成果、原型 (Prototype)、專利技術及具商業化潛力之創新技術，與臺灣企業直接交流合作。每所大學將擁有專屬展示攤位，現場將由 TTO 主管介紹技術特色、技術成熟度 (TRL)、專利布局及可授權技術，方便臺灣企業進行快速的技術評估與媒合。

技術移轉論壇 (Technology Transfer Forum)

本次論壇將邀請各大學技術移轉中心 (TTO) 主管分享：

- ▶ 技術授權制度
- ▶ 智慧財產管理
- ▶ 技術商品化流程
- ▶ 成功案例分享
- ▶ 大學新創 (University Spin-off) 模式
- ▶ 大學與企業合作經驗

協助臺灣企業深入了解美國大學及台灣各大學技術移轉制度，促進更多技術授權及合作機會。

一對一合作媒合 (Business Matching)

大會將安排一對一媒合交流，協助美國大學及台灣各大學與臺灣企業及研究機構建立合作關係，合作內容包括：

- | | |
|--------|--------|
| ✓ 技術授權 | ✓ 聯合研發 |
| ✓ 委託研究 | ✓ 產學合作 |

- ✓ 科技人才培育
- ✓ 新創合作
- ✓ 亞洲市場拓展
- ✓ 美國市場拓展

透過精準媒合，促成大學與臺灣企業、美國大學及州政府代表的直接對話，探討多元合作模式，並促進具體合作成果。

與會美方單位

州政府代表：

確認出席：亞利桑那州、愛達荷州、德州、蒙大拿州、華盛頓州
已邀請：新墨西哥州、馬里蘭州、密蘇里州

大學與企業：

- 亞利桑那大學 (University of Arizona)
- 北亞利桑那大學 (Northern Arizona University)
- 博伊西州立大學 (Boise State University)
- 愛達荷大學 (University of Idaho)
- 蒙大拿州立大學 (Montana State University)
- 蒙大拿州創新科技公司 (Montana Innovation Technology)等

美方州政府代表與州大學持續增加中

高峰會資訊

活動名稱	2026 臺美科技人才、創新研發暨產業投資合作高峰會
活動副標	打造臺美人才供應鏈、技術移轉、創新研發與產業投資合作平台
主辦單位	台灣學聯 (Taiwan Aeon Corporation)
日期	2026 年 9 月 2 日 (星期三)
地點	台北凱撒大飯店四樓寶島廳 (台北車站正對面)

活動時程規劃

時間	活動內容
14:30 - 15:00	人員報到

15:00 - 15:05	開場致詞
15:05 - 15:45	美國各州政府投資環境、產業優勢及招商投資政策分享
15:45 - 16:20	美國大學 研究成果技術移轉與商業化實務分享
16:20 - 16:45	美國教授 創新技術研發成果、產品應用與商業化分享
16:45 - 17:05	台灣大學 創新研發成果、技術移轉、企業合作與國際鏈結交流
17:05 - 17:30	台灣教授 創新技術研發成果、產品應用與商業化分享
17:30 - 18:30	一對一媒合
18:30 - 20:30	晚宴交流

我們深信，貴校在科技創新、學術研究及技術商品化方面的卓越成就，將為本次高峰會帶來寶貴的經驗與國際影響力。誠摯邀請貴校蒞臨臺灣，共同打造臺美科技人才培育、創新研發、技術移轉及產業合作的新典範，攜手建立長期且深厚的國際夥伴關係。

敬祝

校運昌隆 教研卓越

報名截止日期：2026 年 8 月 15 日，經審核通過後，將會發送 E-mail 通知

蔡振良 (Johnny Tsai)

總經理

台灣學聯 (Taiwan Aeon Corporation)

聯絡電話：0938-238086

電子郵件：johnny_tsai@163.com

王予靖 (Gene)

專案經理

台灣學聯 (Taiwan Aeon Corporation)

聯絡電話：02-23660075

電子郵件：tw.careerexpl@gmail.com

附件說明：

有意與會的學校教授，請填寫附件「大學技術成果暨合作需求申請表」，並回覆信件，以利後續安排媒合與展示事宜。